



INTEK-PLUS
Integrated Measurement System



Disclaimer

본 자료에 포함된 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 한국의 기업회계기준에 따라 본사기준으로 작성되었습니다.

본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다.

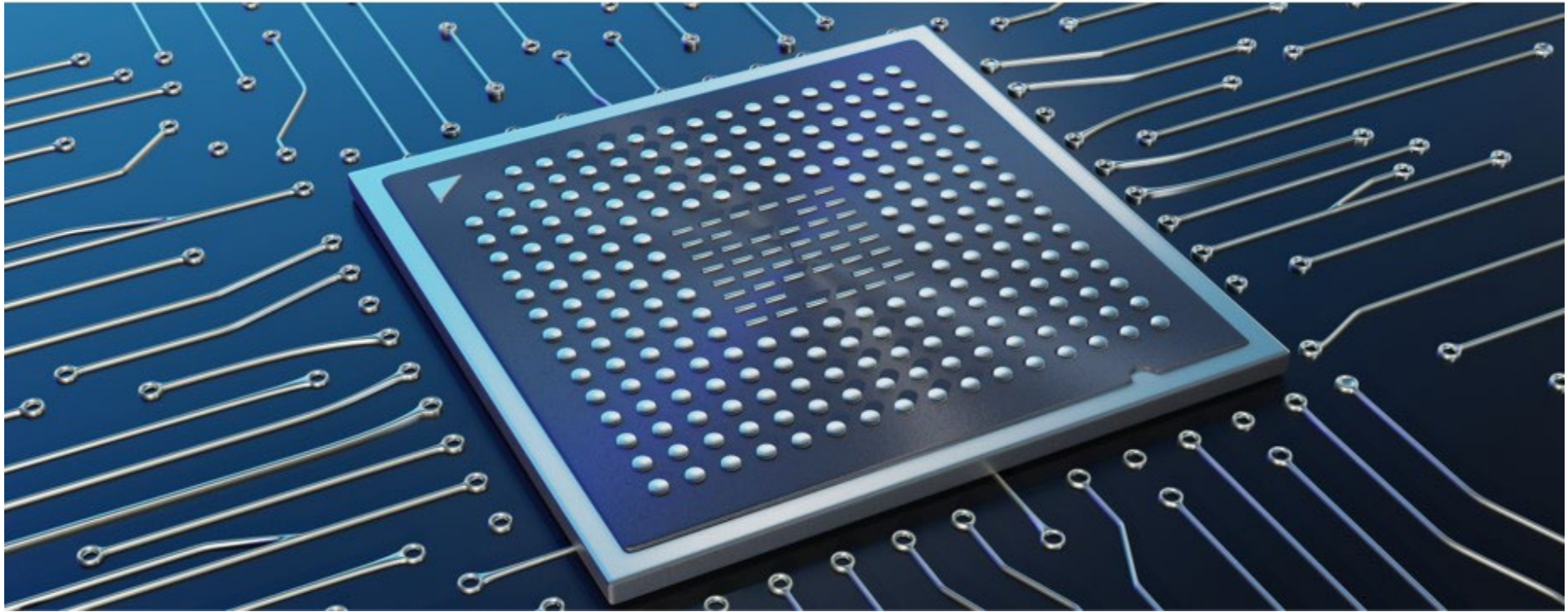
이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', (E) 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

또한 향후 전망은 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로서

향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 달라질 수 있음을 양지 하시기 바랍니다.

본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로써 사용될 수 없습니다.



Contents

**Chapter A.
Corporate Overview**

**Chapter B.
Business Strategy**

Chapter A. Corporate Overview

01. 실적 Review

02. 회사개요

03. 기술역량

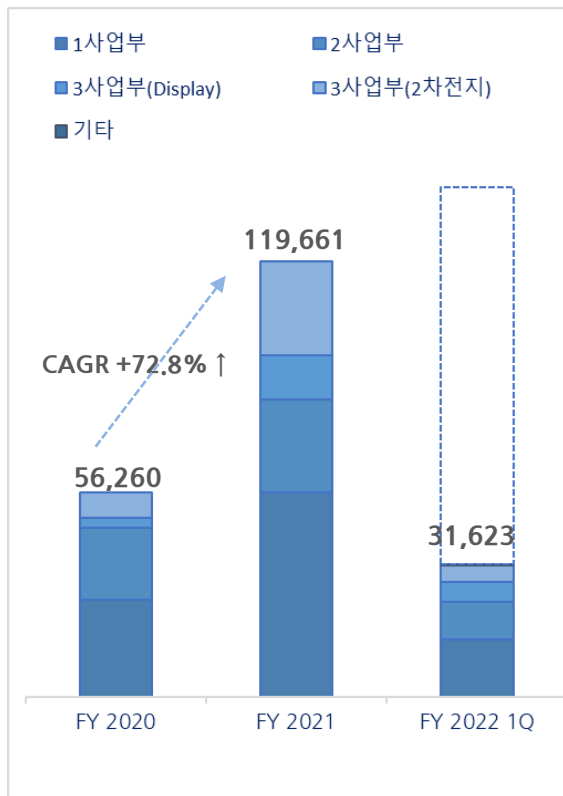
04. 핵심기술

05. 사업분야

전방산업의 BIG CYCLE과 M/S 확대

1Q22 실적

- 1사업부 (반도체 패키지 분야) : 중화권 OSAT향 판매 증가
- 2사업부 (MID-END 분야) : 주요 BGA 기판 고객사 수주 지속
- 3사업부 (Display 분야) : OLED 비전모듈 매출 발생
- 3사업부 (2차전지 분야) : A사의 신규 외관 검사장비 매출 인식



*CAGR : FY2019~ FY2021

2Q22 및 2022년 전망

CAPEX

생산공간 및 업무공간 확충 증설 투자 진행(2021년 2Q~2022년 3Q)

- 1사업부 (반도체 패키지 분야) : Major 고객사 Demo진행, 시장점유율 성장 지속
- 2사업부 (MID-END 분야) : 반도체 기판 분야 증설 수혜 지속
- 3사업부 (Display 분야) : 지속 성장을 위한 사업 모델 구축 지속
- 3사업부 (2차전지 분야) : 주요 고객사 Capex 및 검사공정 확대 수혜 기대

(단위:백만원)

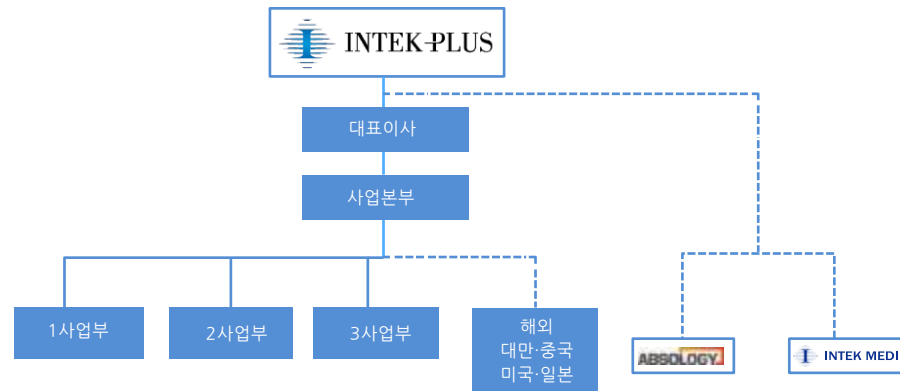
구분	FY 2020	FY 2021	2022 1Q	수주잔고
1사업부 (반도체 패키지)	26,801	56,291	15,900	28,757
2사업부 (MID-END)	19,574	25,422	10,051	28,460
3사업부 (Display)	2,919	12,196	835	1,555
3사업부 (2차전지)	6,966	25,752	4,699	1,826
기타	-	-	138	-
계	56,260	119,661	31,623	60,598

* 반도체 PKG 분야에 MODULE 분야 포함

일반 현황

회사명	(주)인텍플러스
사업영역	2D/3D 외관검사장비
설립일	1995년 10월(상장 2011년 1월)
자본금	63.5억원
임직원수	335명
소재지	대전시 유성구 테크노2로 263

조직도



임원구성

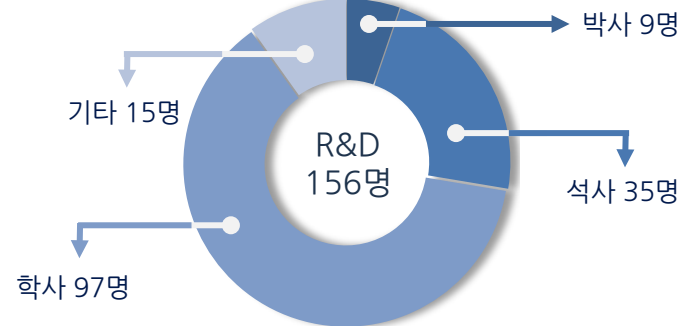
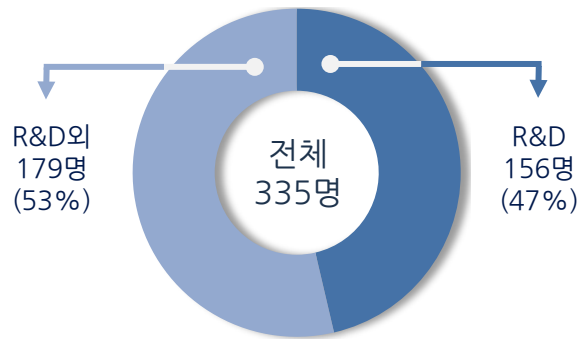
CEO	이 상 윤
학력	· KAIST 기계공학 박사 · 서울대 기계설계 학사/석사
경력	· 한국과학기술원 위촉연구원 · (주)인텍플러스 연구소장 · 現. (주)인텍플러스 대표이사

주요 임원진

최 이 배	· KAIST 기계공학박사 · 現. (주)인텍플러스 사장
강 민 구	· KAIST 기계공학박사 · 現. (주)인텍플러스 전무
유 승 봉	· KAIST 기계공학박사 · 現. (주)인텍플러스 상무

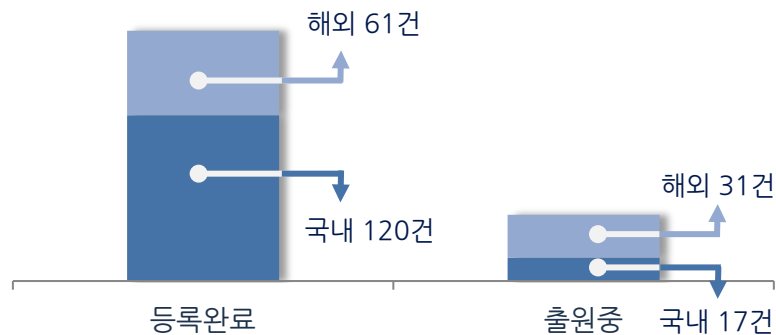
우수한 R&D인력 및 핵심 특허 보유

인력현황



특허현황

181건 특허 보유, 48건 출원 중

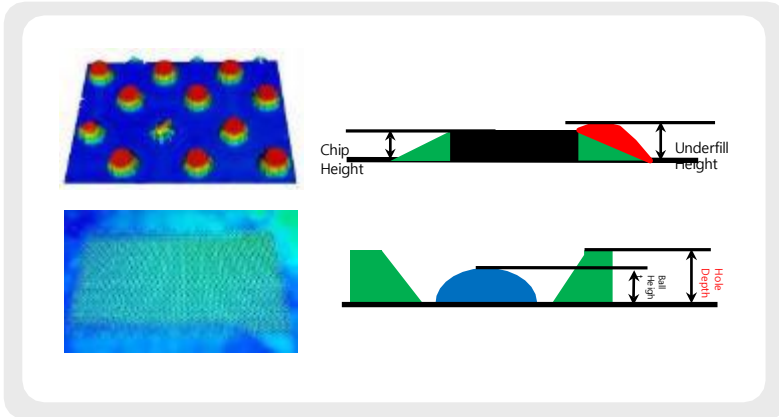


주요 핵심 특허

- 표면 형상 측정 시스템 및 그를 이용한 측정 방법(WSI+3D)
- 광학식 2차원 및 3차원 형상 측정 시스템(Moire+3D)
- 3차원 형상 측정장치 및 측정방법
- 영상 데이터 고속 송/수신 방법 및 영상 장치

외관검사장비 구현을 위한 원천기술

고속3D 검사기술



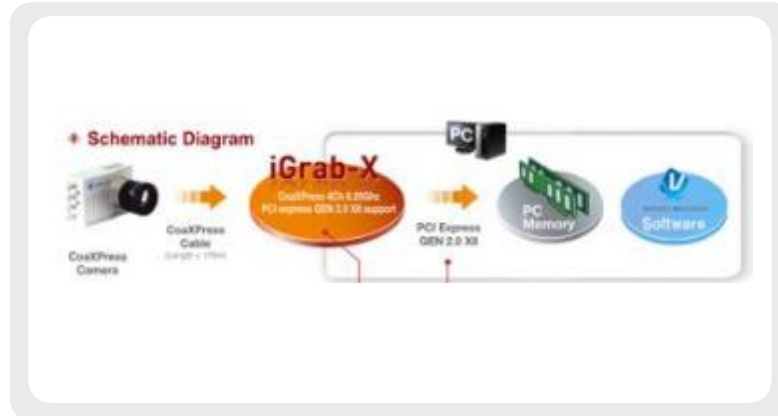
자동화 장비 설계 및 제작 기술



2D 검사기술



고속 영상 획득 및 처리 기술



머신 비전 기술을 바탕으로 다양한 분야의 검사 솔루션 제공

원천기술

머신 비전 기술

- ✓ 고속 3D 측정 기술
- ✓ 다양한 2D 검사 기술
- ✓ 핸들러 설계 및 제작
- ✓ 영상획득/처리기술

One Source
Multi Use

다양한 검사
솔루션 제공

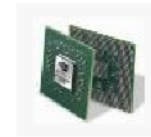
반도체분야



IC PACKAGE



MEMORY MODULE



FC SUBSTRATE



SSD

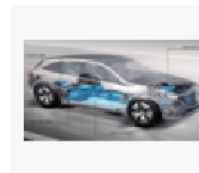


BUMPED WAFER

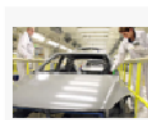
자동차용 2차전지



Pouch Type Battery 검사



Smart Factory



도장 전
자세 검사



프레스 검사



3D Sensor

Display 분야



Flexible OLED

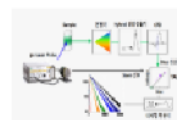


LCD Display

바이오 분야



체외진단(POCT)



형광수명현미경

Chapter B. Business Area

01. 반도체 PKG 분야(1사업부)

02. MID - END 분야 (2사업부)

03. Display 분야 (3사업부)

04. 2차전지 및 검사자동화 분야 (3사업부)

05. 의료분야 (계열사)

06. 중장기 성장 전략

반도체 BIG CYCLE 및 시장점유율 확대 지속

시장점유율 증가 : 신규 고객사 추가 및 고객사 내 점유율 증가 지속

글로벌 메이저 고객사들과의 파트너십 강화 지속

반도체 후공정 고도화 및 메모리 반도체 세대 변경에 따른 사업기회 지속

1Q22 실적

- 매출 전년 동기 대비 110% 증가
- 주요 OSAT향 판매 전년 동기 대비 97% 증가

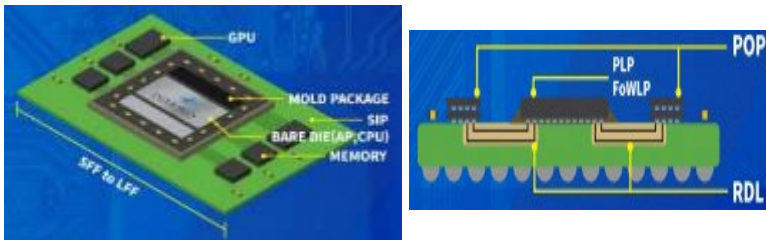
2Q22 예상

- 북미, 중화권 OSAT향 수주 견조
- 신규 메이저 OSAT 업체 Demo 진행

2022년 예상

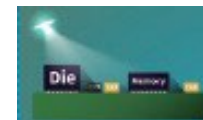
- Major OSAT 고객사 확대 지속
- 패키지 고도화 트렌드로 인한 성장 지속 예상
- 메모리모듈 세대변경에 따른 신제품 니즈 발생

High-end PKG Trends



Advanced PKG - Heterogeneous Integration

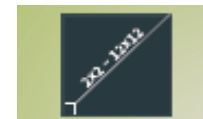
Supreme Vision Solution



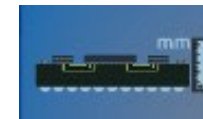
Shadow Free



Micro Crack



SFF to LFF Size Coverage



Total Height



AI Deep Learning

차세대 고성능 반도체 구현의 핵심 영역

5G, HPC, AI, 자율주행차 등 Advanced Package 기술 적용의 확대에 의한 투자 지속
시장 점유율 확대 속에 주요 반도체 기판 업체들의 투자 확대 지속

1Q22 실적

- 주요 BGA 기판업체들의 투자로 인한 수주 견조
- 전년 동기 대비 수주 잔고 97% 증가
- 전 분기 대비 매출 76% 증가

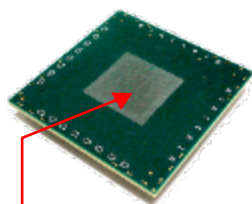
2Q22 예상

- 고객사 투자 확대에 의한 수주 증가 지속
- 고성능 패키지 기판의 수요 증가에 따른 주요 고객사들의 증설 지속

2022년 예상

- 주요 메이저 기판 업체 투자 지속
- 반도체 기판 신규 업체 출현에 따른 기회 확대
- 반도체 기판 검사장비 라인업 확대

FC-BGA Bump 외관검사

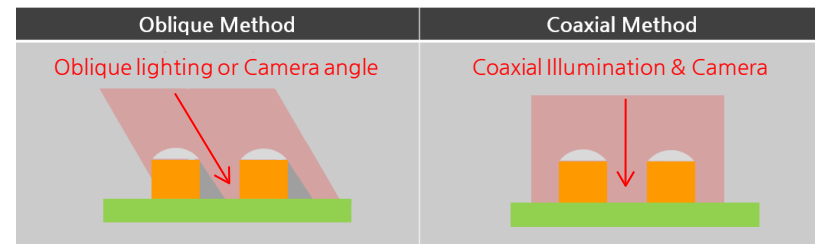


fine pitch bump

C4 Area

- Bump Height/ Coplanarity
- Chip Attach-area Warpage
- Bump Diameter/ offset
- Thickness Variation
- Bump damage
- Bridge/ Missing bump
- Scratch

Bump 3D Inspection Solutions



고객사 다변화 및 검사공정 확대

주요 Flexible OLED Cell 업체들의 검사장비 투자 진행 예정
외관검사 솔루션 적용 공정 확대

1Q22 실적

- OLED 비전모듈 매출 발생
- 전분기 대비 소폭 매출 감소

2Q22 예상

- 폴더블 제품 관련 검사 솔루션 공급

2022년 예상

- 폴더블 제품 관련 외관검사기 수혜 예상
- 지속적인 성장을 위한 사업 모델 구축
(OLED 셀검사기, 비전 모듈, 중국 합자법인)

OLED 셀 외관 검사장비



비전모듈



2차전지 산업의 검사 공정 확대 기회

신규 검사 솔루션 개발 및 글로벌 2차전지 업체 공략

1Q22 실적

- A사 수주에 대한 납품 및 매출 인식

2Q22 예상

- A사 신규 검사 공정 납품 및 안정화 지속

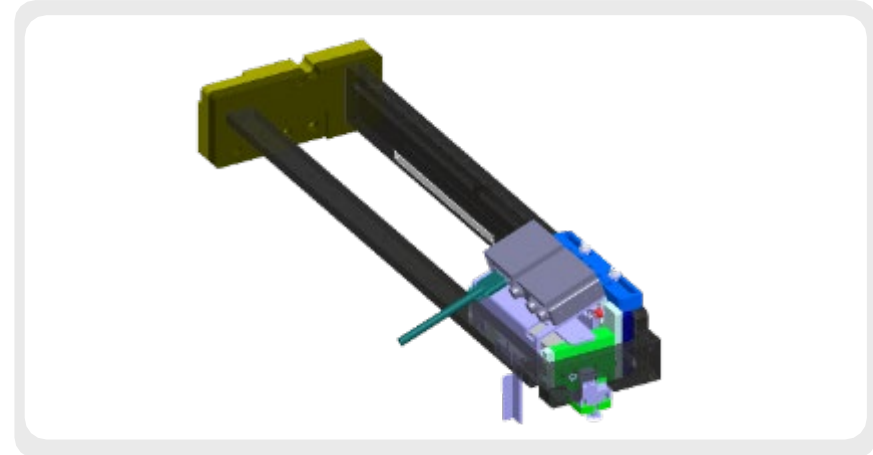
2022년 예상

- 주요 고객사의 Capex 및 공정확대 기회
- 2차전지 산업 성장에 따른 장기적 성장 기반 마련

Cell 외관 검사 장비



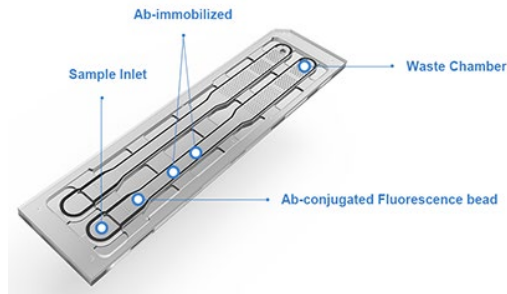
비전모듈



의료분야

인텍플러스가 보유한 머신비전기술 관련 분야의 기술과 네트워크 활용으로 사업 다각화 추진
기술 사업화 참여 및 엔젤 투자

ABSOLOGY - POCT Technology



앱솔로지



POCT (PSA, VTD, TST, TSH)
- 국내, 유럽 인허가 완료, 판매시작
- 미국 FDA 승인을 위한 IRB 진행
HS ELISA : 협심증, 치매 개발 임상 진행중(서울대 병원) CO
VID 19 신속진단키트: 수출용 제조허가 완료

INTEKMEDI - 체외진단장비



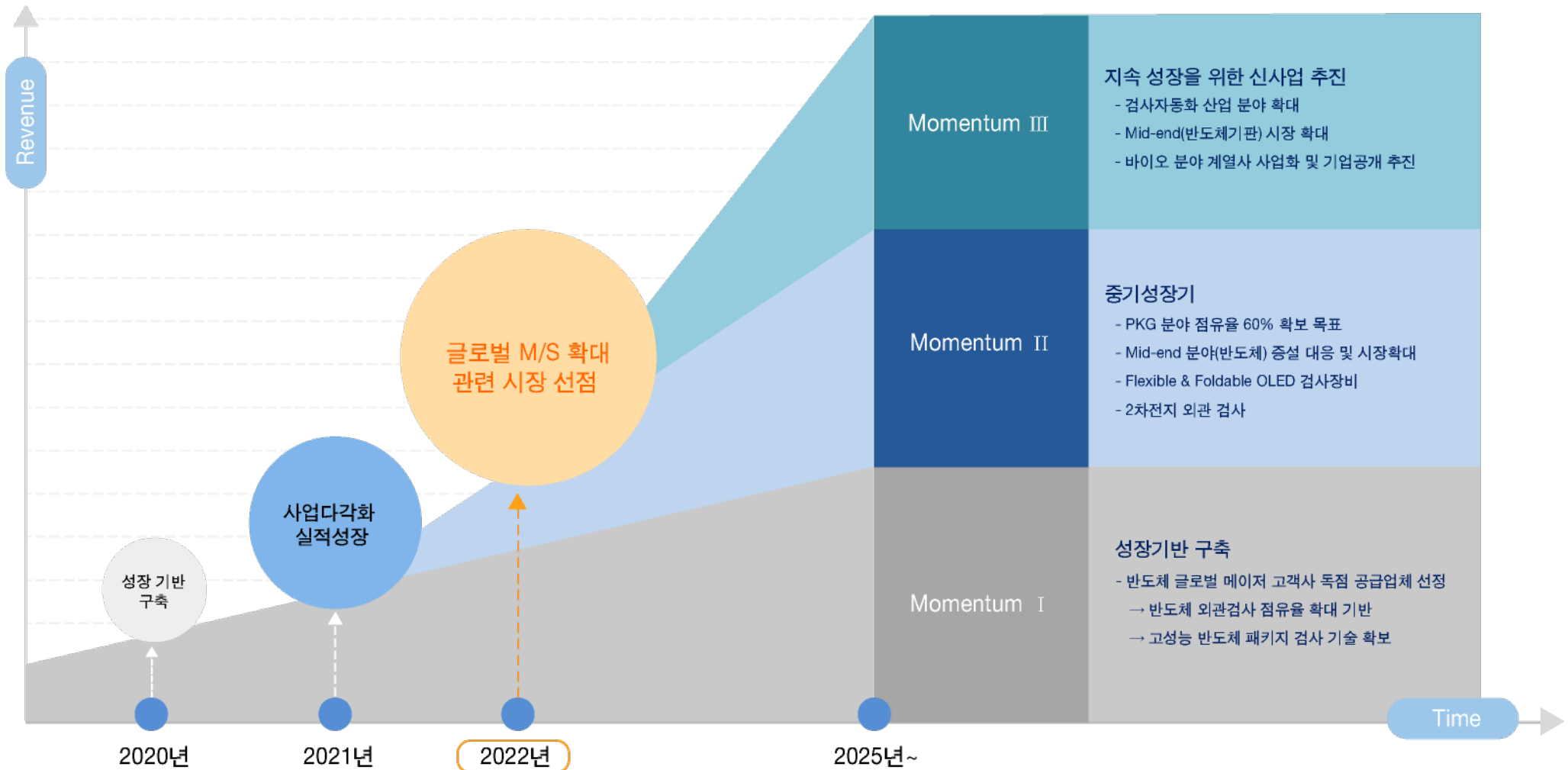
인텍메디



- 동방진단기기 (형광수명)
- 맞춤형 현장진단 체외진단 장비
- 스마트 복강경 조직절제기

사업다각화를 통한 중장기성장 지속

HPC, 데이터센터, 5G, 자율주행차, 인공지능, Flexible 디스플레이, 2차전지 등 전방 산업의 장기적 성장 수혜 지속
글로벌 레퍼런스 인지도 확대 - 기술선점 및 고객사 확보 효과





본사 대전광역시 유성구 테크노2로 263 | www.intekplus.com